

S FHJ 0 200-Q 型 平行缝焊机系统

本缝焊机系统为具有真空加热干燥、气体保护功能的平行缝焊机。

平行缝焊机是半导体集成电路、晶振、声表面滤波器、混合电路、电源模块和正在兴起的光纤通讯中需要的各种转接、分配器等部件生产后道工序封装以及激光器件封装的关键设备，尤其是用在封装气密性和其它指标的要求越来越高的军事、高精尖技术上的元器件，更显其突出的优越性。

平行缝焊是一种先进的低温焊接技术，用于替代预置焊料的融化焊接。其主要原理是：利用电流通过电阻时的发热原理，在被焊接的器件的被焊接部位产生高热并使其快速融化、粘结，达到壳体与盖板的焊接。

S FHJ 0 200-Q 型平行缝焊机（系统）首先对被焊接的零部件进行真空加热（温度可控）处理，确保被加工零部件表面的可挥发物、残存的水汽全部处理干净；第二，采用气体（氮气）保护技术，使焊接加工环境可以完全与周边环境隔离（采用气体隔离手套箱）；第三，采用高频脉冲（可调）电流焊接，其焊接点距、散热系数可调，确保壳体温度不超过允许值；第四，焊接过程中，盖板与壳体之间始终承受一定（可调）的压力，克服因盖板变形造成的焊接质量下降和保证焊接的密封指标达到要求。

1、 用途

主要用于微电子和光伏激光行业中对被加工部件的气密性、水汽含量、颗粒碰撞物要求较高的矩形或者圆形的金属底座、陶瓷金属化基座和盖板的平行缝焊。

该设备特别适用于操作技术成熟、对产品的气密性、水汽含量等要求较高的企业。

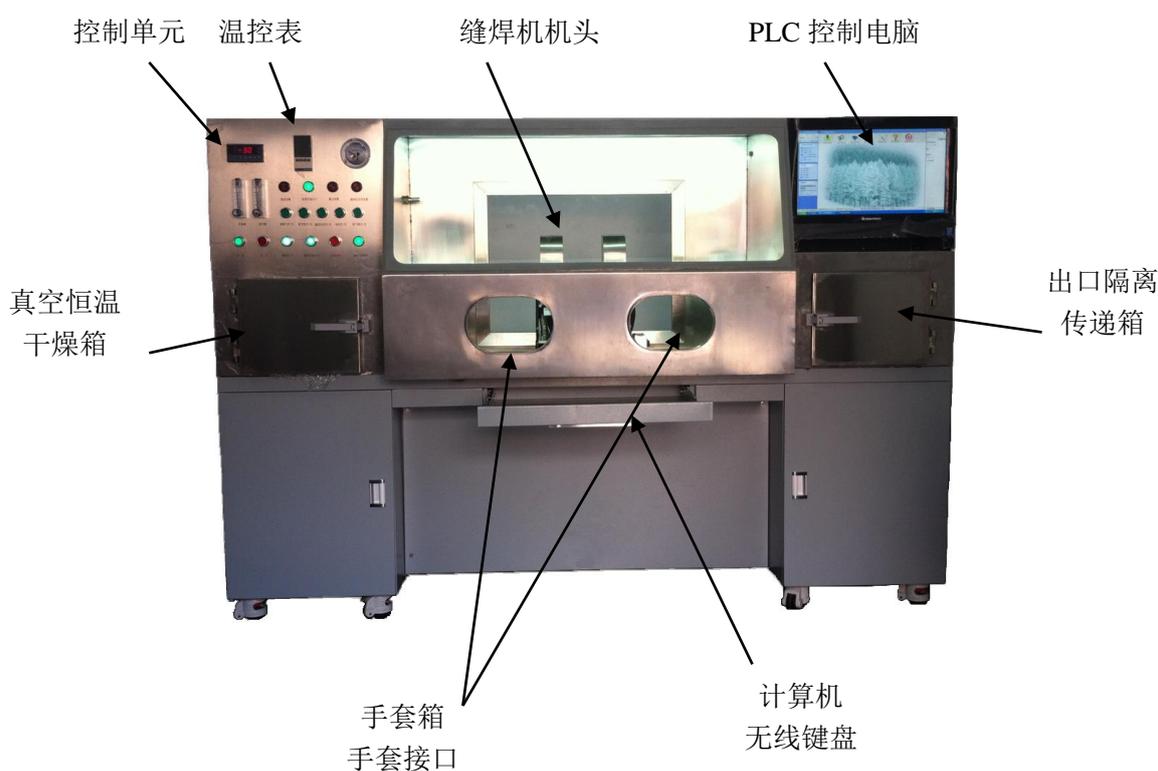
2、特点

- 采用高频脉冲焊接 —— 其焊接质量优于工频焊接；
- 焊接参数的调整简单、直观 —— 焊接的点距、散热系数等参数用户可以根据需要自行调整，确保被缝焊零件焊接后的气密性和表面温升符合要

求；

- 可靠的真空干燥箱——实现完全与空气隔绝干燥，并具有气体保护，防止表面氧化；
- 结构合理的手套箱系统——开启、维修简单；带有进出口传递箱，与外界有效隔离；
- 友好的用户界面——进行了较好的人性化设计，易于操作，调取、更改加工数据简单；
- 具有系统故障和机械运动故障保护功能。

设备示意图——只表示设备结构，具体细节需要根据最终设计确定



2、 技术指标

输入电源：AC220V 25A 50Hz

缝焊压力：300~3000g 可调

焊接频率：10KHz

24 小时技术支持及售后

13573816096

缝焊电源容量： $\geq 4\text{KW}$

最快焊接速度：45cm/分钟

重复定位精度：0.01mm

烘箱极限真空度：-0.1MPa（机械真空泵）

烘箱真空保持时间：不低于 48 小时

烘箱温度：室温~200°C 可调

烘箱温度控制： $\pm 1\text{ }^{\circ}\text{C}$

烘箱干燥空间：需要依据用户产品确定

加工部件尺寸：

矩形： $(3\sim 200) \times (3\sim 200)\text{ mm}$

盖板边缘厚度：0.08mm~0.3mm

管壳材料：可伐（表面镀镍、镀金）、陶瓷（表面金属化处理）、不锈钢、无氧铜（表面镀镍或金）

手套箱内氮气保护：2~10L/分钟

手套箱洁净度：达到万级净化

根据用户的需要可加氮气净化装置、水氧分析仪或装露点仪等仪表装置（型号、价格由用户确定、费用由用户承担）。